



平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年4月26日
上場取引所 東

上場会社名 東京エレクトロン デバイス株式会社
コード番号 2760 URL <http://www.teldevice.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 栗木 康幸

問合せ先責任者 (役職名) 財務部長

(氏名) 田中 弘毅

定時株主総会開催予定日 平成24年6月20日

配当支払開始予定日

TEL 045-443-4000

有価証券報告書提出予定日 平成24年6月20日

平成24年5月31日

決算補足説明資料作成の有無 : 有

決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期の連結業績(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期	86,300	△5.5	2,011	△26.7	2,332	△20.7	960	△49.9
23年3月期	91,315	7.2	2,745	32.0	2,941	38.9	1,918	64.5

(注) 包括利益 24年3月期 892百万円 (△52.8%) 23年3月期 1,892百万円 (70.0%)

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり 当期純利益	自己資本当期純利 益率	総資産経常利益率	売上高営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
24年3月期	9,064.37	—	4.1	4.8	2.3
23年3月期	18,095.67	—	8.5	6.1	3.0

(参考) 持分法投資損益 24年3月期 一百万円 23年3月期 一百万円

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
24年3月期	46,391	23,381	50.4	220,584.82
23年3月期	50,254	23,220	46.2	219,063.50

(参考) 自己資本 24年3月期 23,381百万円 23年3月期 23,220百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	現金及び現金同等物期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
24年3月期	4,602	△383	△4,330	1,264
23年3月期	△1,877	△676	2,321	1,373

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産配当 率(連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
23年3月期	—	3,000.00	—	3,600.00	6,600.00	699	36.5	3.1
24年3月期	—	3,300.00	—	3,300.00	6,600.00	699	72.8	3.0
25年3月期(予想)	—	3,300.00	—	3,300.00	6,600.00		42.4	

3. 平成25年3月期の連結業績予想(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純 利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	44,000	5.3	950	△24.8	560	△19.9	5,283.02
通期	98,000	13.6	2,700	15.7	1,650	71.7	15,566.04

※ 注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 無
- ② ①以外の会計方針の変更： 無
- ③ 会計上の見積りの変更： 無
- ④ 修正再表示： 無

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	24年3月期	106,000 株	23年3月期	106,000 株
② 期末自己株式数	24年3月期	— 株	23年3月期	— 株
③ 期中平均株式数	24年3月期	106,000 株	23年3月期	106,000 株

（参考）個別業績の概要

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	％	百万円	％	百万円	％	百万円	％
24年3月期	73,621	△8.1	1,735	△19.7	2,473	△3.3	1,099	△31.0
23年3月期	80,135	5.6	2,161	27.1	2,556	32.1	1,592	62.3

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期	10,374.10	—
23年3月期	15,027.54	—

(2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	％	円 銭
24年3月期	45,927	23,113	50.3	218,048.92
23年3月期	49,449	22,811	46.1	215,206.71

（参考）自己資本 24年3月期 23,113百万円 23年3月期 22,811百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する説明等については、添付資料2ページ「1.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 経営成績	2
(1)経営成績に関する分析	2
(2)財政状態に関する分析	3
(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当	4
(4)事業等のリスク	5
2. 企業集団の状況	7
3. 経営方針	8
(1)会社の経営の基本方針	8
(2)目標とする経営指標	8
(3)中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題	9
4. 連結財務諸表	10
(1)連結貸借対照表	10
(2)連結損益計算書及び連結包括利益計算書	12
(3)連結株主資本等変動計算書	14
(4)連結キャッシュ・フロー計算書	16
(5)継続企業の前提に関する注記	17
(6)追加情報	17
(7)連結財務諸表に関する注記事項	17
(セグメント情報)	17
(1株当たり情報)	19
(重要な後発事象)	19
5. その他	20
(1)仕入、受注及び販売の状況	20
(2)役員の異動	21

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①当期の経営成績

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の影響やタイで発生した洪水によってサプライチェーンに混乱が生じ、また、円高基調が続くなど景気を下押しする要因が混在する中、北米景気の持ち直しや日銀による追加金融緩和を背景に円高局面が後退するなど明るさも見え始めております。しかしながら、原油価格の高騰や欧州債務危機の悪化懸念等、先行きに対して警戒感が残る状況となっております。

当社グループが参画しているエレクトロニクス業界では、スマートフォンやタブレットPCに代表されるモバイル端末市場は順調な拡大を示しておりますが、テレビ等を中心としたデジタル家電製品に対する需要は総じて減退しております。IT投資においては、震災の影響による一時的な縮小傾向が見られたものの、企業や社会活動におけるIT活用意識の高まりを背景としたクラウドコンピューティングの拡大等、徐々に回復の動きが見られます。

このような状況のもと、当連結会計年度の売上高は863億円（前期比5.5%減）、営業利益は20億1千1百万円（前期比26.7%減）、経常利益は23億3千2百万円（前期比20.7%減）、当期純利益は9億6千万円（前期比49.9%減）となりました。

当社グループにおける報告セグメントに係る業績については、次のとおりであります。

[半導体及び電子デバイス事業]

スマートフォン向け商品の一部は伸長しておりますが、テレビ等のデジタル家電関連に対する需要が停滞したことにより、専用IC・メモリーICの売上が低調に推移したことに加え、これまで好調であった産業機器向け半導体製品の需要が減速するなど、様々な分野で需要が冷え込んだ結果、売上高は676億9千9百万円（前期比7.7%減）、セグメント利益（経常利益）は10億9千4百万円（前期比47.6%減）となりました。

[コンピュータシステム関連事業]

スマートフォンの普及等に伴うデータ通信量の増加を背景とした、企業におけるクラウドコンピューティングへの需要拡大やデータセンターの利用増加により、コンピュータ・ネットワーク機器の製品販売及び保守ビジネスが堅調に推移した結果、売上高は186億円（前期比3.6%増）、セグメント利益（経常利益）は12億3千8百万円（前期比45.2%増）となりました。

②次期の見通し

国内電機メーカーの事業縮小や民生機器関連の需要が下降するなど、エレクトロニクス業界は厳しい状況が続いております。

当社グループでは、半導体及び電子デバイス事業においてこれまで培ってきた技術力や地域密着型の営業活動に基づく既存取引先とのビジネスに加え、新たに獲得した商権を活用し、海外展開も含めた成長を見込んでおります。また、コンピュータシステム関連事業では、クラウドコンピューティングの更なる普及を背景としたデータセンターの利用拡大等に対し、高付加価値製品やソリューションの提供を図ることで、顧客への直接販売体制の強化を推進してまいります。

これらの内容を踏まえ、平成25年3月期の通期連結業績見通しについては、売上高980億円（前期比13.6%増）、経常利益27億円（前期比15.7%増）、当期純利益16億5千万円（前期比71.7%増）を見込んでおります。

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末における総資産は463億9千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ38億6千3百万円の減少となりました。これは主に、受取手形及び売掛金、商品及び製品が減少したことによります。負債総額は230億9百万円となり、前連結会計年度末に比べ40億2千4百万円の減少となりました。これは主に、買掛金、短期借入金が減少したことによります。また、純資産総額は233億8千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億6千1百万円の増加となりました。以上の結果、自己資本比率は50.4%となり前連結会計年度末に比べ4.2ポイント向上いたしました。

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて1億8百万円減少し、12億6千4百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は46億2百万円(前年同期は18億7千7百万円の使用)となりました。これは主に仕入債務の減少等の資金減少要因があった一方、売上債権の減少、棚卸資産の減少等の資金増加要因がこれを上回ったためであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、3億8千3百万円(前年同期は6億7千6百万円の使用)となりました。これは主にソフトウェアライセンス料の支払い、検査・障害検証用備品代金の支払い、事務所の増床に伴う設備及び工事代金の支払いによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は43億3千万円(前年同期は23億2千1百万円の収入)となりました。これは配当金の支払い及び短期借入金の返済によるものです。

	第26期	第27期
	平成23年3月	平成24年3月
自己資本比率	46.2%	50.4%
時価ベースの自己資本比率	33.5%	34.2%
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	—	1.0
インタレスト・カバレッジ・レシオ	—	158.9

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※ 1 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※ 2 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により計算しております。

※ 3 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。

※ 4 平成23年3月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、記載しておりません。

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、株主重視を経営の最重要事項の一つと位置付けており、継続的かつ安定的な配当実施を基本として、業績を反映した適正な利益還元を原則としております。内部留保金については、持続的な利益成長による企業価値の向上を目指すため、営業活動の整備・強化に加え、自社ブランド商品の開発や海外事業展開、ITインフラ整備等、業容拡大のための投資に有効活用してまいります。これらの観点から、当面の配当性向の水準については連結当期純利益の35%程度を目安といたします。

第27期（平成24年3月期）に係る剰余金の配当につきましては、継続的かつ安定的な配当実施という基本方針を勘案し、取締役会決議により、期末配当を3,300円、中間配当3,300円と合わせた年間配当を1株につき6,600円とする予定であります。

なお、次期（平成25年3月期）の配当予想については、1株当たり年間配当金6,600円（中間3,300円・期末3,300円）を予定しております。

(4) 事業等のリスク

①業績の変動要因について

当社グループでは、半導体をはじめとした国内外のエレクトロニクス商品、自社ブランド商品、ネットワーク機器及びソフトウェア等を主に取り扱っております。半導体及び電子デバイス事業では、得意先が大手エレクトロニクスメーカー等であることから、半導体需要や設備投資動向に影響を受ける可能性があります。コンピュータシステム関連事業では、顧客がネットワークやシステムの構築・整備に関連した企業や団体等であることから、IT投資等の設備投資に係る動向に影響を受ける可能性があります。当社グループでは従来より、付加価値が高く、価格変動が比較的少ない商品の取り扱いを増やすことなどを通じ、これらの影響を回避する方策を採っておりますが、取引相手先を含めたエレクトロニクス業界全体の需給バランスが悪化することにより、当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。

②為替変動の影響について

当社グループは、エレクトロニクス商品の輸出入取引を行っており、また、一部の国内顧客との間において外貨建取引を行っております。取引発生時と決済時の為替変動リスクに関しては、為替予約によってリスク回避に努めております。また、為替変動による仕入価格の変動に関しては、仕入価格の動向を勘案して販売価格を改定する等の方策を採っておりますが、急激な為替変動は当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。

③仕入先の依存度について

当社グループの主要な仕入先は、日本テキサス・インスツルメンツ株式会社、リニアテクノロジー社及びザイリンクス社であり、平成24年3月期における当社グループの総仕入実績に対する割合はそれぞれ13.5%、12.0%及び10.3%となっております。各社とは取引基本契約を締結し、これまで取引関係は安定的に推移してきましたが、このような取引関係が継続困難となった場合や、主要仕入先の製品需要の動向によっては、当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。

④親会社等との関係について

当社グループは、当社の親会社である東京エレクトロン株式会社（持株比率55.4%）を中核とした東京エレクトロングループ（以下「グループ」といいます。）の一員であり、半導体電子部品及びコンピュータ・ネットワーク部門を担っております。グループはその他、半導体製造装置及びFPD/PV（フラットパネルディスプレイ及び太陽電池）製造装置の製造子会社並びにグループ内のサービス子会社で構成されており、グループ内で事業の棲み分けが図られているため、当社グループと競合関係にある会社はありません。

なお、平成24年3月期における当社グループとグループ会社との取引関係、人的関係等は次のとおりであります。しかしながら、当社グループとグループ会社との取引関係、人的関係の安定性は保証されているわけではありません。

A. 営業取引

a. 親会社・・・仕入高2,539千円、売上高25,194千円

仕入は主に売上原価として計上されるエンジニアリングセンターの土地賃借料の支払いであり、土地賃借料は固定資産税評価額を基準に算定し、協議の上決定しております。売上は顧客の要望に応じて親会社を経由して販売する場合及び当社商品を親会社に販売する場合であり、取引条件は当社の商品の市場価格から算定した価格によっております。

b. 親会社以外のグループ会社・・・仕入高41,807千円、売上高1,416,423千円

仕入は主に売上原価として計上される東京エレクトロンエージェンシー株式会社に対する保険料の支払いであり、取引条件は一般的な取引条件を勘案し、協議の上決定しております。売上は半導体製造装置及びFPD/PV（フラットパネルディスプレイ及び太陽電池）製造装置の製造子会社に対する当社商品の販売であり、取引条件は当社の商品の市場価格から算定した価格によっております。

B. 営業取引以外の取引

a. 親会社・・・47,281千円

主にコンピュータ使用料及びエンジニアリングセンターの土地賃借料の支払いであり、コンピュータ使用料は一般的な取引条件を勘案し、また、土地賃借料は固定資産税評価額を基準に算定し、協議の上決定しております。

b. 親会社以外のグループ会社・・・420,797千円

主に東京エレクトロンBP株式会社に対する給与計算業務委託費及びリース料等の支払いであります。いずれも取引条件は一般的な取引条件を勘案し、協議の上決定しております。

C. 親会社からの役員受入

半導体業界に幅広い人的ネットワークと見識を兼ね備えた親会社の人材を受け入れることは、当社経営の一助となると考えております。なお、日常の経営意思決定並びに業務執行については、当社常勤役員により行われておりますので、経営の独立性は確立していると考えております。

親会社の役員等による兼任状況は次のとおりであります。

氏 名	当社における役職	親会社における役職
東 哲郎	取締役（非常勤）	取締役会長
中村 隆	取締役（非常勤）	取締役

2. 企業集団の状況

当社を中心とする企業集団は、当社、親会社及び子会社5社（連結子会社3社、非連結子会社2社）で構成されております。

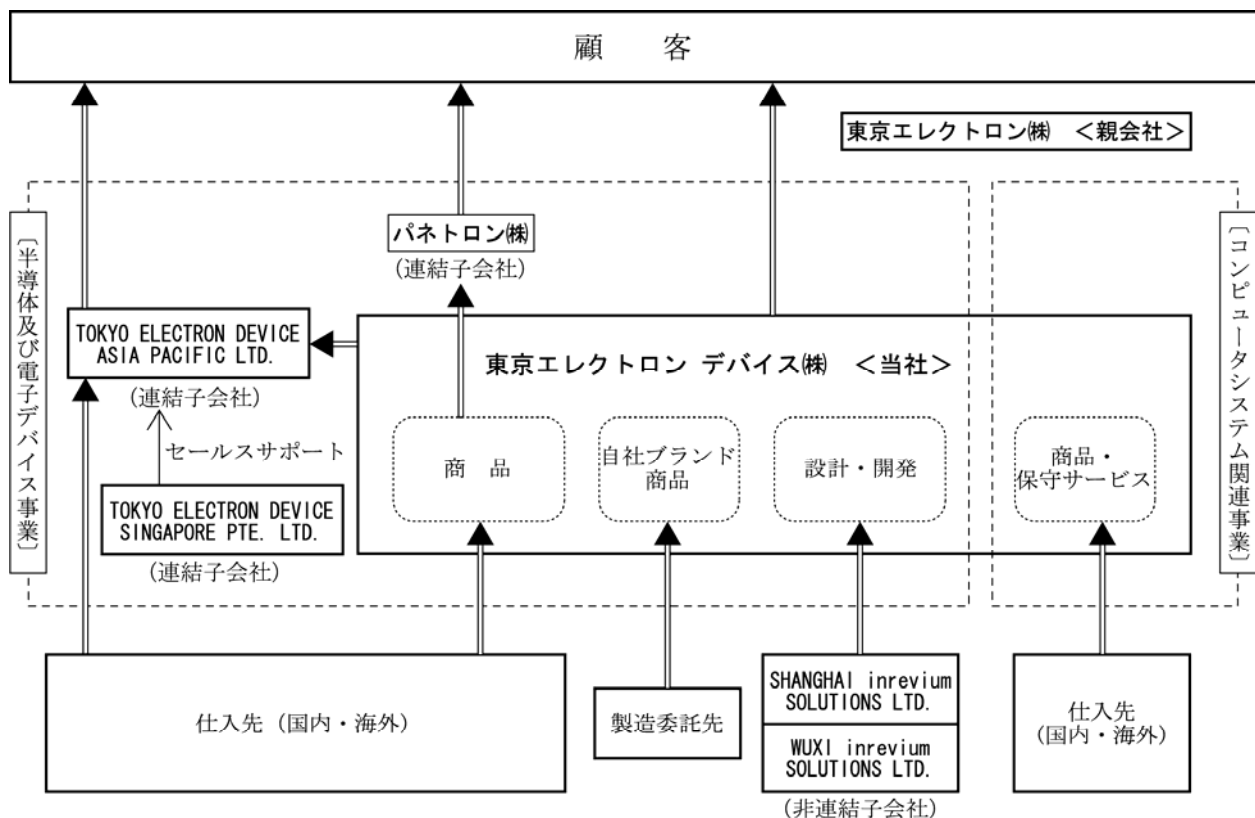
当社グループ（当社及び当社の子会社）は、集積回路を中心とした半導体製品、ボード製品、一般電子部品、ネットワーク機器、ストレージ機器、ソフトウェア等、国内外のエレクトロニクス商品及び自社ブランド商品を主として大手エレクトロニクスメーカーに販売しております。

当社の連結子会社であるパネトロン株式会社は、国内のエレクトロニクスメーカーに対し、当社取り扱い商品とは異なる商品の販売を行っており、TOKYO ELECTRON DEVICE ASIA PACIFIC LTD. は、アジアパシフィックに生産拠点を展開する日系顧客を中心に商品の販売を行っており、その子会社であるTOKYO ELECTRON DEVICE SINGAPORE PTE. LTD. はTOKYO ELECTRON DEVICE ASIA PACIFIC LTD. に対する営業事務サポートを担っております。

当社の非連結子会社であるSHANGHAI inrevium SOLUTIONS LTD. 及びWUXI inrevium SOLUTIONS LTD. は、当社が委託した半導体等の回路設計・開発及びソフトウェアの設計・開発を行っております。

当社の親会社である東京エレクトロン株式会社は、半導体製造装置及びFPD/PV（フラットパネルディスプレイ及び太陽電池）製造装置等の製造・販売を主な事業としております。

<事業の系統図>



※図中の矢印は、商品及びサービスの流れを示しております。

- (注)1 TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG LTD. は平成24年3月にTOKYO ELECTRON DEVICE ASIA PACIFIC LTD. へ社名変更しております。
- 2 TOKYO ELECTRON DEVICE SINGAPORE PTE. LTD. は平成24年3月にTOKYO ELECTRON DEVICE ASIA PACIFIC LTD. の完全子会社（当社の間接所有100%となる連結子会社）となっております。
- 3 TOKYO ELECTRON DEVICE (SHANGHAI) LTD. は平成24年3月にSHANGHAI inrevium SOLUTIONS LTD. へ呼称変更しております。
- 4 TOKYO ELECTRON DEVICE (WUXI) LTD. は平成24年3月にWUXI inrevium Solutions LTD. へ呼称変更しております。

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、①技術力向上に努め、②高付加価値ビジネスを志向し、③安定した利益成長を図り、④エレクトロニクス社会の発展へ貢献することを経営の基本方針としております。この基本方針のもと、株主、顧客及び従業員の満足度向上に取り組んでまいります。

(2) 目標とする経営指標

当社では、ローリング方式による「3ヶ年計画」を平成23年6月15日付で発表いたしました。今般、その内容について見直しを行い、現在までの業績推移及び今後の事業環境等を勘案し、新たな3ヶ年計画（平成25年3月期～平成27年3月期）を、以下のとおりといたします。

当社グループでは、次項の「中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題」に記載した内容に基づき、時機に応じた具体的施策を講じて3ヶ年計画の実現を目指してまいります。

(単位：百万円)

(連結)	第27期・実績 (平成24年3月期)	第28期 (平成25年3月期)	第29期 (平成26年3月期)	第30期 (平成27年3月期)
売 上 高	86,300	98,000	113,000	130,000
経 常 利 益	2,332	2,700	3,700	4,800
当期純利益	960	1,650	2,250	2,900

※ ご参考：前回（平成23年6月15日）発表数値

(連結)	第27期	第28期	第29期
売 上 高	95,000	110,000	125,000
経 常 利 益	3,250	4,000	5,000
当期純利益	1,950	2,400	3,000

(3) 中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題

エレクトロニクス業界における当社グループを取り巻く事業環境等を踏まえ、中長期的な事業戦略と経営における課題として、以下の内容について取り組んでまいります。

① 半導体及び電子デバイス事業の強化

仕入先・顧客の双方から信頼されるきめ細やかな技術サポートを提供し、更なる商権の獲得に努めてまいります。

設計・開発能力と技術力の向上を目指し、自社ブランドである「inrevium（インレビウム）」商品の企画と販売強化に努め、設計（デザインサービス）や量産（OEM）の受託・開発ビジネスを展開してまいります。

アジア地域の拠点を拡充し、従来の日系企業向けビジネスに加え、現地企業の開拓と販売促進活動に注力いたします。

② コンピュータシステム関連事業の強化

大量のデータ処理や災害リスクの分散等、クラウドコンピューティングの進展に伴うデータセンターの拡大に対応し、システムの導入支援・システム構築・保守サポートサービスを行っていくための体制整備を図り、顧客に最適なIT環境の提案を進めてまいります。

③ 新規事業への進出

環境・省エネルギー関連商品のマーケティングを強化し、取り扱い商品のラインアップ拡充を継続してまいります。

④ コーポレート・ガバナンスの充実等

継続的な企業価値向上の実現にあたり、コンプライアンスの徹底、内部統制システムの整備、リスク管理及び適切な情報の管理を行い、経営の透明性・客観性を確保するとともに、企業の社会的責任（CSR）を果たしてまいります。

4. 連結財務諸表
(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,373,240	1,264,865
受取手形及び売掛金	21,025,318	20,434,456
商品及び製品	19,247,439	16,590,132
仕掛品	99,889	90,930
繰延税金資産	838,845	746,673
その他	2,817,518	2,786,115
貸倒引当金	△151,076	△142,817
流動資産合計	45,251,175	41,770,356
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	1,528,991	1,559,302
減価償却累計額	△492,186	△620,277
建物及び構築物 (純額)	1,036,805	939,025
工具、器具及び備品	1,549,137	1,625,607
減価償却累計額	△1,139,429	△1,321,685
工具、器具及び備品 (純額)	409,707	303,922
リース資産	28,767	28,767
減価償却累計額	△12,984	△18,924
リース資産 (純額)	15,783	9,842
建設仮勘定	7,321	1,673
有形固定資産合計	1,469,616	1,254,463
無形固定資産		
その他	390,339	429,324
無形固定資産合計	390,339	429,324
投資その他の資産		
投資有価証券	18,000	18,000
繰延税金資産	2,005,159	1,915,180
その他	1,132,325	1,013,261
貸倒引当金	△11,776	△9,478
投資その他の資産合計	3,143,707	2,936,963
固定資産合計	5,003,664	4,620,752
資産合計	50,254,839	46,391,108

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	7,360,850	5,915,821
短期借入金	7,996,405	4,402,726
未払法人税等	463,167	606,311
前受金	2,523,846	2,932,667
賞与引当金	1,052,640	841,663
役員賞与引当金	42,150	41,526
その他	1,841,922	2,145,414
流動負債合計	21,280,981	16,886,131
固定負債		
退職給付引当金	5,141,885	5,487,908
役員退職慰労引当金	128,698	155,022
その他	482,543	480,055
固定負債合計	5,753,127	6,122,986
負債合計	27,034,108	23,009,117
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,495,750	2,495,750
資本剰余金	5,645,240	5,645,240
利益剰余金	15,238,358	15,467,781
株主資本合計	23,379,348	23,608,772
その他の包括利益累計額		
繰延ヘッジ損益	△29,659	△96,639
為替換算調整勘定	△128,959	△130,141
その他の包括利益累計額合計	△158,618	△226,781
純資産合計	23,220,730	23,381,990
負債純資産合計	50,254,839	46,391,108

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)
売上高	91,315,782	86,300,226
売上原価	75,147,488	70,945,877
売上総利益	16,168,294	15,354,348
販売費及び一般管理費		
給料及び手当	4,855,631	5,105,420
賞与引当金繰入額	1,008,615	819,957
退職給付引当金繰入額	786,090	784,371
その他	6,772,248	6,633,111
販売費及び一般管理費合計	13,422,585	13,342,860
営業利益	2,745,708	2,011,488
営業外収益		
受取利息	174	106
受取配当金	300	4,608
為替差益	235,796	84,620
償却債権取立益	—	216,130
その他	36,146	88,209
営業外収益合計	272,418	393,675
営業外費用		
支払利息	33,789	28,977
売上債権売却損	32,695	32,185
支払保証料	9,772	11,002
その他	0	0
営業外費用合計	76,257	72,166
経常利益	2,941,868	2,332,997
特別利益		
固定資産売却益	31	—
投資有価証券売却益	70,850	—
貸倒引当金戻入額	48,693	—
特別利益合計	119,574	—
特別損失		
固定資産売却損	—	51
固定資産除却損	41,085	11,113
ゴルフ会員権評価損	7,622	10,349
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	42,694	—
賃貸借契約解約損	32,144	—
災害による損失	30,502	—
特別損失合計	154,051	21,514
税金等調整前当期純利益	2,907,391	2,311,483
法人税、住民税及び事業税	1,126,591	1,129,549
法人税等調整額	△137,340	221,109
法人税等合計	989,250	1,350,659
少数株主損益調整前当期純利益	1,918,141	960,823
当期純利益	1,918,141	960,823

連結包括利益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	1,918,141	960,823
その他の包括利益		
繰延ヘッジ損益	37,508	△66,980
為替換算調整勘定	△63,344	△1,182
その他の包括利益合計	△25,836	△68,163
包括利益	1,892,305	892,660
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	1,892,305	892,660
少数株主に係る包括利益	—	—

(3) 連結株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	2,495,750	2,495,750
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	2,495,750	2,495,750
資本剰余金		
当期首残高	5,645,240	5,645,240
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	5,645,240	5,645,240
利益剰余金		
当期首残高	13,903,216	15,238,358
当期変動額		
剰余金の配当	△583,000	△731,400
当期純利益	1,918,141	960,823
当期変動額合計	1,335,141	229,423
当期末残高	15,238,358	15,467,781
株主資本合計		
当期首残高	22,044,207	23,379,348
当期変動額		
剰余金の配当	△583,000	△731,400
当期純利益	1,918,141	960,823
当期変動額合計	1,335,141	229,423
当期末残高	23,379,348	23,608,772

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)
その他の包括利益累計額		
繰延ヘッジ損益		
当期首残高	△67,167	△29,659
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	37,508	△66,980
当期変動額合計	37,508	△66,980
当期末残高	△29,659	△96,639
為替換算調整勘定		
当期首残高	△65,614	△128,959
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△63,344	△1,182
当期変動額合計	△63,344	△1,182
当期末残高	△128,959	△130,141
その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	△132,781	△158,618
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△25,836	△68,163
当期変動額合計	△25,836	△68,163
当期末残高	△158,618	△226,781
純資産合計		
当期首残高	21,911,425	23,220,730
当期変動額		
剰余金の配当	△583,000	△731,400
当期純利益	1,918,141	960,823
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△25,836	△68,163
当期変動額合計	1,309,305	161,260
当期末残高	23,220,730	23,381,990

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	2,907,391	2,311,483
減価償却費	469,093	593,238
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△353,393	△10,557
賞与引当金の増減額 (△は減少)	197,725	△210,945
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	15,992	△624
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	426,715	346,023
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	26,175	26,324
受取利息及び受取配当金	△474	△4,715
支払利息	33,789	28,977
為替差損益 (△は益)	1,133	109
有形固定資産売却損益 (△は益)	△31	51
有形固定資産除却損	40,351	11,030
無形固定資産除却損	734	82
投資有価証券売却損益 (△は益)	△70,850	—
ゴルフ会員権評価損	7,622	10,349
災害損失	15,310	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△259,690	589,299
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△3,809,798	2,638,231
仕入債務の増減額 (△は減少)	257,569	△1,421,609
未収消費税等の増減額 (△は増加)	△376,698	256,050
その他	408,522	448,670
小計	△62,810	5,611,471
利息及び配当金の受取額	474	4,715
利息の支払額	△33,780	△28,968
法人税等の支払額	△1,781,349	△984,480
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,877,465	4,602,738
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△501,298	△240,200
有形固定資産の売却による収入	365	48
無形固定資産の取得による支出	△112,261	△185,773
投資有価証券の売却による収入	67,706	—
その他	△131,366	42,141
投資活動によるキャッシュ・フロー	△676,854	△383,783
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	2,910,423	△3,592,581
配当金の支払額	△583,000	△731,400
リース債務の返済による支出	△5,950	△6,237
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,321,472	△4,330,218
現金及び現金同等物に係る換算差額	△15,175	2,889
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△248,022	△108,374
現金及び現金同等物の期首残高	1,621,262	1,373,240
現金及び現金同等物の期末残高	1,373,240	1,264,865

(5) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(6) 追加情報

(法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年12月2日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成24年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の40.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成24年4月1日から平成27年3月31日までのものは38.0%、平成27年4月1日以降のものについては35.6%にそれぞれ変更されております。

その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が320,612千円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が316,560千円増加し、繰延ヘッジ損益が4,052千円減少しております。

(7) 連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報)

1 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績評価をするために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、製品・サービス別の販売体制のもと事業活動を展開しており、「半導体及び電子デバイス事業」及び「コンピュータシステム関連事業」の2つを報告セグメントとしております。

「半導体及び電子デバイス事業」は、半導体製品、その他電子部品等を販売しており、「コンピュータシステム関連事業」は、コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア等を販売しております。

2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 平成22年4月 1 日 至 平成23年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額	連結財務諸表 計上額 (注)
	半導体及び 電子デバイス 事業	コンピュータ システム関連 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	73,354,497	17,961,284	91,315,782	—	91,315,782
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	—	—	—
計	73,354,497	17,961,284	91,315,782	—	91,315,782
セグメント利益	2,089,315	852,552	2,941,868	—	2,941,868
セグメント資産	41,186,684	9,068,154	50,254,839	—	50,254,839
その他の項目					
減価償却費	206,075	249,160	455,235	—	455,235
受取利息	165	8	174	—	174
支払利息	32,087	1,702	33,789	—	33,789
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	556,783	214,144	770,927	—	770,927

(注) セグメント利益の合計額は、連結損益計算書の経常利益と一致しております。

当連結会計年度(自 平成23年4月 1 日 至 平成24年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額	連結財務諸表 計上額 (注)
	半導体及び 電子デバイス 事業	コンピュータ システム関連 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	67,699,990	18,600,236	86,300,226	—	86,300,226
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	—	—	—
計	67,699,990	18,600,236	86,300,226	—	86,300,226
セグメント利益	1,094,677	1,238,320	2,332,997	—	2,332,997
セグメント資産	37,778,424	8,612,684	46,391,108	—	46,391,108
その他の項目					
減価償却費	311,248	257,937	569,186	—	569,186
受取利息	102	3	106	—	106
支払利息	27,681	1,296	28,977	—	28,977
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	245,081	151,783	396,865	—	396,865

(注) セグメント利益の合計額は、連結損益計算書の経常利益と一致しております。

(1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)
1株当たり純資産額	219,063円50銭	220,584円82銭
1株当たり当期純利益	18,095円67銭	9,064円37銭

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載していません。

2 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)
当期純利益(千円)	1,918,141	960,823
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る当期純利益(千円)	1,918,141	960,823
普通株式の期中平均株式数(株)	106,000	106,000
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	平成16年6月18日定時株主総会決議ストックオプション普通株式300株。平成17年6月21日定時株主総会決議ストックオプション普通株式350株。	

3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	23,220,730	23,381,990
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	—	—
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	23,220,730	23,381,990
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)	106,000	106,000

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

5. その他

(1) 仕入、受注及び販売の状況

① 仕入実績

仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	前連結会計年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)	
	仕入高 (千円)	増減率 (%)	仕入高 (千円)	増減率 (%)
半導体及び電子デバイス事業	66,687,912	14.5	55,571,257	△16.7
コンピュータシステム関連事業	12,170,194	△0.0	12,708,354	4.4
合計	78,858,106	12.0	68,279,611	△13.4

(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 受注実績

受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの 名称	前連結会計年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)				当連結会計年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)			
	受注高 (千円)	増減率 (%)	受注残高 (千円)	増減率 (%)	受注高 (千円)	増減率 (%)	受注残高 (千円)	増減率 (%)
半導体及び電子 デバイス事業	73,760,786	4.2	9,520,976	4.5	66,389,140	△10.0	8,210,126	△13.8
コンピュータ システム関連事業	18,558,110	0.3	5,156,325	13.1	19,088,636	2.9	5,644,726	9.5
合計	92,318,897	3.4	14,677,302	7.3	85,477,777	△7.4	13,854,853	△5.6

(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3 金額は販売価格によっております。

③ 販売実績

販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	前連結会計年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)	
	販売高 (千円)	増減率 (%)	販売高 (千円)	増減率 (%)
半導体及び電子デバイス事業	73,354,497	8.8	67,699,990	△7.7
コンピュータシステム関連事業	17,961,284	1.4	18,600,236	3.6
合計	91,315,782	7.2	86,300,226	△5.5

(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 役員の異動〔平成24年6月20日予定〕

(代表取締役の異動)

該当事項はありません。

(新任取締役候補)

氏 名	現在の役職	異動後の役職
初見 泰男	執行役員 ECプロダクト統括本部長、PLD事業部長	取締役 執行役員 ECプロダクト統括本部長、PLD事業部長

(退任予定取締役)

氏 名	現在の役職	異動後の役職
木村 勉	取締役 執行役員専務 パネトロン株式会社 代表取締役社長	パネトロン株式会社 代表取締役社長